



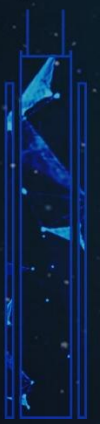
高峰论坛
GHCTC

2018全球硬科技创新 暨“一带一路”创新合作大会

The Global Hard & Core Technology Innovation
and The Belt and Road Innovative Cooperation Conference 2018

中国·西安 XI'AN, CHINA

2018.11.8-11



2018 国际金融科技与区块链产业高峰论坛

活动时间：2018年11月9日（星期五）

活动地点：西安君悦酒店

主办单位：中共西安市委、西安市人民政府

承办单位：中国人民银行西安分行

中国中小企业协会信用管理中心

执行单位：中国计算机学会区块链专业委员会

陕西西部资信股份有限公司

会议规模：200-300人

会议简介：当前，以区块链、大数据、人工智能等为代表的“硬科技”，在金融领域集中落地。时代风起云涌、科技瞬息万变，以信用为抓手的金融产业枝繁叶茂，以区块链应用为代表的硬科技千帆竞发。恰逢西安市“2018全球硬科技创新暨“一带一路”科技合作大会”召开之际，配合西安打造“全球硬科技之都”，围绕“硬科技发展西安，硬科技改变世界、硬科技决胜未来”的大会主题，“创新金融科技，链接信用未来”，共话金融科技、信用、及区块链的三者之间的关系与未来发展。特于举办“2018国际金融科技与区块链产业高峰论坛”。

议程安排 (以现场最终安排为准)

2018 国际金融科技与区块链产业高峰论坛

2018年11月9日(星期五)

08:00-09:00	嘉宾签到
09:00-09:30	领导致辞
09:30-10:30	嘉宾演讲
10:30-10:45	授牌仪式
10:45-11:00	签约仪式(战略合作协议)
11:00-12:00	高端对话
12:10-14:00	午餐, 休息
14:00-14:50	主旨报告
14:50-17:30	中小企业信用信息商业化应用研讨会

活动咨询

联系人: 刘媛

电话: 15911053832